

概要

この通知は、MSL 1 の VOG8 パッケージにおいて、リード フレームのインナーリード部に、10% 未満の確率で剥離が生じる可能性があることをお知らせするものです。この剥離によるプレコンディショニング後の電氣的不具合は発生しません。また、将来的な信頼性にも影響致しません。

MSL 3 の条件で同パッケージを検査した結果、インナーリード部の剥離は確認されませんでした。このため、同パッケージの耐湿性レベルは、JEDEC STD-020C に従って、MSL 1 から MSL 3 へ変更されました。

内容

VOG8 パッケージを MSL 1 でプレコンディショニング後、耐湿性に起因したインナーリード部の剥離について解析を続けた結果、この剥離による電氣的不具合は発生しません。また将来的な信頼性にも影響致しません。

VOG8 パッケージを MSL 3 でプレコンディショニングした結果、インナーリード部の剥離は確認されませんでした。この検証は、JEDEC STD-020C で規定された条件 (30 / 60% RH 条件で 192 時間放置後、鉛フリーの IR リフローを 3 回、ピーク温度 260) で実施されました。

このパッケージの耐湿性レベルは MSL 1 から MSL 3 に変更されたため、これらのデバイスの保管期間は 168 時間に制限されます。

該当製品

この変更は、コマーシャル (C) グレードおよびインダストリアル (I) グレード デバイスのすべてのスピード / パッケージ / 温度の組み合わせに影響します。車載および Q グレード デバイスは該当しません。該当するデバイス番号を次の表に示します。

表 1: 該当製品

デバイス名	
XC1736EVOG8C	XC17S200AVOG8C
XC17128EVOG8C	XC17S10XLVOG8C
XC1765ELVOG8C	XC17S10XLVOG8I
XC17S15AVOG8C	XC17S20XLVOG8C
XC17S50AVOG8C	XC17S30XLVOG8C
XC17S100AVOG8C	

推奨

デバイスは、ドライパック開封後、168 時間以内に PCB に実装して下さい (JEDEC-STD-020C 参照)。

お問合せ先

この通知に関するお客様からの返答は必要ありません。ご不明な点、ご質問等ございましたら、[ザイリンクス テクニカル サポート](#)までお問い合わせ下さい

重要なお知らせ：カスタマ変更通知 (PCN、PDN、Quality Alert) は、弊社のウェブサイト MySupport <http://www.xilinx.co.jp/mysupport> からの e-mail によるアラート配信として受信できます。この MySupport でご登録後、

マイアラートにカスタマ変更通知が含まれるようにカスタマイズして下さい。この変更により、指定された製品に関する新規および更新情報、データシートやエラッタ、アプリケーション ノートなどに関するアラートを受け取ることができるようになります。登録方法につきましては、[ザイリンクス アンサー 18683](#) を参照して下さい。

改訂履歴

次の表に、この通知の改訂履歴を示します。

日付	バージョン	変更内容
2006/01/16	1.0	初版リリース
2006/03/02	1.1	表 1 のデバイス名に「C」、「I」を追加および変更。

この通知は、英語版 (XCN06001、バージョン 1.1、2006 年 3 月 2 日発行) を翻訳したものです。